FA-CN-0159-D

对应于ANSI/ISA-12.12.01的额定铭牌和模块前部的标记变更

■出版年月
2016年11月 （2022年5月修订D版）
■相关机型
MELSEC-Q系列、MELSEC iQ-R系列

感谢您继续支持三菱电机MELSEC-Q系列和MELSEC iQ-R系列可编程控制器。
我们将依据ANSI/ISA-12.12.01的认证变更额定铭牌和模块前部上的标记。
这些变更不会影响模块的一般规格、性能规格、功能和外观尺寸。

1 变更原因

为了通过ANSI/ISA-12.12.01认证。

2 变更详情

额定铭牌标记内容的变更

重新审核额定铭牌的标记内容，并变更为符合ANSI/ISA-12.12.01标准的标记。

模块前部标记内容的变更 （仅限MELSEC-Q系列）

仅对配有RS-232端子 （圆型连接器）的机型，在靠近端子的位置增加了警告标志 （⚠）。
该标志表示在关闭电源时或是不涉及危险的场所外不得对RS-232电缆进行插拔或解除连接。

3 ANSI/ISA-12.12.01认证

通过ANSI/ISA-12.12.01认证的三菱电机产品可在 I类，2区，A、B、C和D组中使用。

• 关于危险场所的定义

危险场所	内容
I类	从易燃气体、易燃液体产生的蒸气等在空气中的所含量足以产生爆炸性或易燃性混合物的场所
2区	正常动作条件下，不太可能存在起燃浓度的易燃气体或蒸气。
A组	易燃气体/蒸气 （例如：乙炔）
B组	易燃气体/蒸气 （例如：氢气）
C组	易燃气体/蒸气 （例如：乙烯）
D组	易燃气体/蒸气 （例如：丙烷）

4 变更机型

额定铭牌的变更 （MELSEC-Q系列）

变更时期依机型而异。在流通过程中，变更前后的产品可能会同时存在。敬请谅解。

机型名称	型号	变更时期
通用型QCPU	Q03UDECPU、Q04UDEHCPU、Q06UDEHCPU、Q10UDEHCPU、Q13UDEHCPU、Q20UDEHCPU、Q26UDEHCPU、Q50UDEHCPU、Q100UDEHCPU	2014年9月及以后
	Q03UDVCPU、Q04UDVCPU、Q04UDPVCPU、Q06UDVCPU、Q06UDPVCPU、Q13UDVCPU、Q13UDPVCPU、Q26UDVCPU、Q26UDPVCPU	2016年1月及以后
过程CPU	Q02PHCPU、Q06PHCPU、Q12PHCPU、Q25PHCPU	2014年9月及以后
冗余CPU	Q12PRHCPU、Q25PRHCPU	
C语言控制器模块	Q12DCCPU-V	2016年1月及以后
主基板模块	Q35B、Q38B、Q312B	2014年9月及以后
扩展基板模块	Q65B、Q68B、Q612B	
冗余电源主基板模块	Q38RB	
冗余电源扩展基板模块	Q68RB	2016年1月及以后
用于冗余系统的扩展基板模块	Q65WRB	2014年9月及以后
电源模块	Q61P、Q62P、Q63P、Q64PN	
付有寿命检测功能的电源模块	Q61P-D	2016年1月及以后
用于冗余电源系统的电源模块	Q63RP、Q64RP	2014年9月及以后
	Q64RPN	2016年1月及以后
输入模块	QX10、QX70、QX71、QX72、QX80、QX81、QX82	2014年9月及以后
	QX42	2016年1月及以后
输出模块	QY10、QY22、QY70、QY71、QY80、QY81P	2014年9月及以后
	QY82P	2016年1月及以后
中断模块	QI60	2014年9月及以后
模-数转换模块	Q66AD-DG、Q68AD-G	
	Q62AD-DGH、Q64AD、Q64ADH、Q64AD-GH、Q68ADV、Q68ADI	2016年1月及以后
数-模转换模块	Q62DA-FG、Q66DA-G	2014年9月及以后
	Q62DAN、Q64DAH、Q64DAN、Q68DAVN、Q68DAIN	2016年1月及以后
模拟输入输出模块	Q64AD2DA	
测力传感器输入模块	Q61LD	2014年9月及以后
测温电阻体输入模块	Q64RD-G、Q68RD3-G	
	Q64RD	2016年1月及以后
热电偶输入模块	Q64TDV-GH、Q68TD-G-H02	2014年9月及以后
	Q64TD、Q68TD-G-H01	2016年1月及以后
温度调节模块	Q64TCRTN、Q64TCRTBWN、Q64TCTTN、Q64TCTTBWN	
环路控制模块	Q62HLC	2014年9月及以后
通道间绝缘脉冲输入模块	QD60P8-G	
以太网模块	QJ71E71-100	
串行通信模块	QJ71C24N、QJ71C24N-R2、QJ71C24N-R4	
PROFIBUS-DP模块	QJ71PB92V、QJ71PB93D	
高速数据记录器模块	QD81DL96	
CC-Link IE控制网络模块	QJ71GP21-SX、QJ71GP21S-SX	
CC-Link IE现场网络模块	QJ71GF11-T2	2016年1月及以后
MELSECNET/H模块	QJ71LP21-25、QJ71LP21S-25、QJ72LP25-25	2014年9月及以后
CC-Link模块	QJ61BT11N	
MODBUS接口模块	QJ71MB91	

机型名称	型号	变更时期
MODBUS/TCP接口模块	QJ71MT91	2014年9月及以后
用于冗余CPU的跟踪电缆	QC10TR、QC30TR	
扩展电缆	QC05B、QC06B、QC30B	

额定铭牌的变更 （MELSEC iQ-R系列）

变更时期依机型而异。在流通过程中，变更前后的产品可能会同时存在。敬请谅解。

机型名称	型号	变更时期
可编程控制器CPU	R04CPU、R08CPU、R16CPU、R32CPU、R120CPU	2015年2月及以后
	R04ENCPU、R08ENCPU、R16ENCPU、R32ENCPU、R120ENCPU	2017年9月及以后
过程CPU	R08PCPU、R16PCPU、R32PCPU、R120PCPU	
C语言控制器模块	R12CCPU-V	
安全CPU	R08SFCPU、R16SFCPU、R32SFCPU、R120SFCPU	
冗余功能模块	R6RFM	
安全功能模块	R6SFM	
主基板模块*1	R33B	2022年6月及以后
	R35B、R38B、R312B	2015年2月及以后
	R310B-HT、R310RB、R38RB-HT	2017年9月及以后
扩展基板模块*1	R65B、R68B、R612B	2015年2月及以后
	R610B-HT、R610RB、R68RB-HT	2017年9月及以后
RQ扩展基板模块*1	RQ65B、RQ68B、RQ612B	2015年2月及以后
电源模块	R61P、R63P	
	R62P、R64P、R63RP、R64RP	2017年9月及以后
输入模块	RX10、RX40C7、RX41C4、RX42C4	2015年2月及以后
	RX40PC6H、RX40NC6H、RX41C6HS、RX61C6HS、RX40NC6B	2017年9月及以后
输出模块	RY10R2、RY40NT5P、RY41NT2P、RY42NT2P、RY40PT5P、RY41PT1P、RY42PT1P	2015年2月及以后
	RY41NT2H、RY41PT2H、RY40PT5B	2017年9月及以后
输入输出合并模块	RH42C4NT2P	2015年2月及以后
模拟输入模块	R60AD4、R60ADV8、R60ADI8	
	R60AD8-G、R60AD16-G、R60ADH4	2017年9月及以后
模拟输出模块	R60DA4、R60DAV8、R60DAI8	2015年2月及以后
	R60DA8-G、R60DA16-G	2017年9月及以后
定位模块	RD75P2、RD75P4、RD75D2、RD75D4	2015年2月及以后
通道间绝缘测温电阻输入模块	R60RD8-G	2017年9月及以后
通道间绝缘热电偶输入模块	R60TD8-G	
温度调节模块	R60TCTRT2TT2、R60TCTRT2TT2BW、R60TCRT4、R60TCRT4BW	
高速计数器模块	RD62P2、RD62P2E、RD62D2	2015年2月及以后
MES接口模块	RD81MES96	2017年9月及以后
高速数据记录器模块	RD81DL96	
C语言智能功能模块	RD55UP06-V	
以太网模块 （带内置CC-Link IE）	RJ71EN71	2015年2月及以后
CC-Link IE控制网络模块	RJ71GP21-SX	
CC-Link IE现场网络模块	RJ71GF11-T2	
	RJ72GF15-T2	2017年9月及以后
CC-Link模块	RJ61BT11	2015年2月及以后
串行通信模块	RJ71C24、RJ71C24-R2、RJ71C24-R4	
扩展SRAM卡盒	NZ2MC-1MBS、NZ2MC-2MBS、NZ2MC-4MBS、NZ2MC-8MBS	2015年2月及以后
	NZ2MC-16MBS、NZ2MC-8MBSE	2017年9月及以后
扩展电缆	RC06B、RC12B、RC30B、RC50B	2015年2月及以后

*1 从2022年5月生产的产品开始，依次将ANSI/ISA-12.12.01认证要求的显示内容从粘贴标签变更为额定铭牌上的显示。(R33B没有标签。)

模块前部的标记变更 （仅限MELSEC-Q系列）

机型名称	型号
过程CPU	Q02PHCPU、Q06PHCPU、Q12PHCPU、Q25PHCPU
冗余CPU	Q12PRHCPU、Q25PRHCPU
MELSECNET/H远程输入输出模块	QJ72LP25-25
C语言控制器模块	Q12DCCPU-V

5 变更部分

本节举例介绍变更部分。

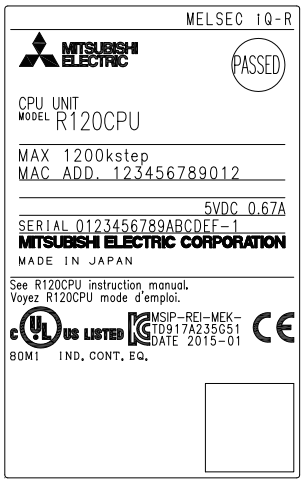
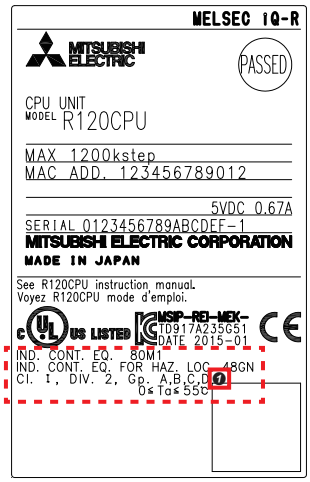
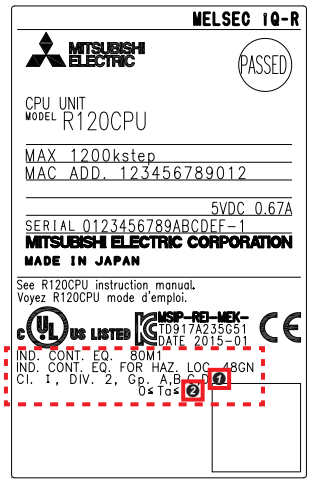
5.1 额定铭牌的标记和配置的变更 （MELSEC-Q系列）

变更前 （例如：过程CPU）	变更后 （例如：过程CPU）
	• 2019年4月之前的情况 变更后的框内标记内容如下： IND. CONT. EQ. 80M1 IND. CONT. EQ. FOR HAZ. LOC. 48GN Cl. I, DIV. 2, Gp. A, B, C, D ❶ 0 ≤ Ta ≤ 55℃ • 2019年4月及以后的情况 添加了框内标记的内容

温度等级 （T4或T4A）标记在❶位置。

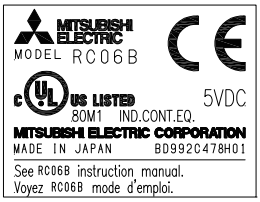
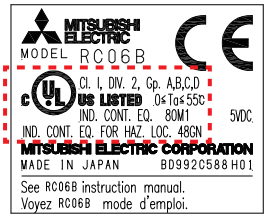
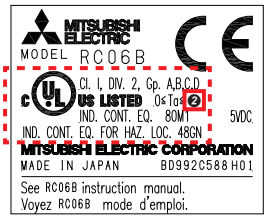
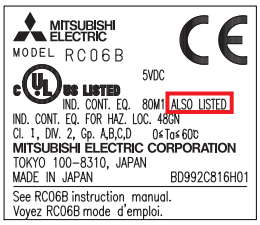
5.2 额定铭牌的标记和配置的变更 （MELSEC iQ-R系列）

各模块和扩展SRAM卡盒

变更前 （例如：可编程控制器CPU）	变更后 （例如：可编程控制器CPU）	
	• 2017年9月之前的情况  变更后的框内标记内容如下： IND. CONT. EQ. 80M1 IND. CONT. EQ. FOR HAZ. LOC. 48GN Cl. I, DIV. 2, Gp. A, B, C, D ❶ 0 ≤ Ta ≤ 55℃ • 2017年9月及以后的情况  变更后的框内标记内容如下： IND. CONT. EQ. 80M1 IND. CONT. EQ. FOR HAZ. LOC. 48GN Cl. I, DIV. 2, Gp. A, B, C, D ❶ 0 ≤ Ta ≤ ❷	• 2019年4月及以后的情况 添加了框内标记的内容

对于输入输出合并模块，温度等级 （T4A）标记在❶位置。
（其他模块未标记温度等级。）
虽然使用环境温度标记在❷位置，但在2017年9月及以后的额定铭牌中，温度会根据机型有所不同。（☞ 7页 关于使用环境温度显示）

扩展电缆

变更前	变更后
	• 2017年9月之前的情况  变更后的框内标记内容如下： Cl. I, DIV. 2, Gp. A, B, C, D 0 ≤ Ta ≤ 55℃ IND. CONT. EQ. 80M1 IND. CONT. EQ. FOR HAZ. LOC. 48GN • 2017年9月及以后的情况  变更后的框内标记内容如下： Cl. I, DIV. 2, Gp. A, B, C, D 0 ≤ Ta ≤ ❷ IND. CONT. EQ. 80M1 IND. CONT. EQ. FOR HAZ. LOC. 48GN • 2019年4月及以后的情况  添加了框内标记的内容

虽然使用环境温度标记在❷位置，但在2017年9月及以后的额定铭牌中，温度会根据机型有所不同。（☞ 7页 关于使用环境温度显示）

关于使用环境温度显示

温度标记在❷位置。

■55℃显示机型

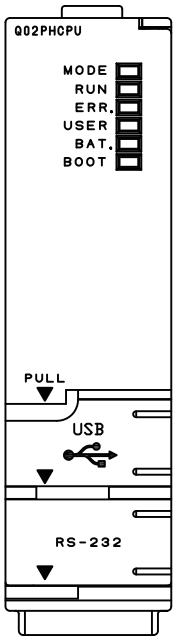
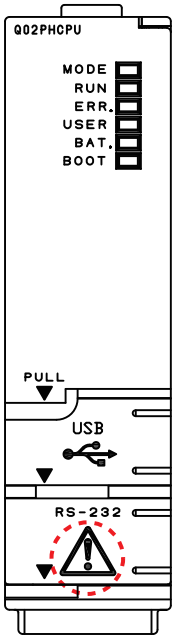
机型名称	型号
可编程控制器CPU	R04ENCPU、R08ENCPU、R16ENCPU、R32ENCPU、R120ENCPU
主基板模块	R310RB、R312B、R38B、R35B
扩展基板模块	R610RB、R612B、R68B、R65B
RQ扩展基板模块	RQ612B、RQ68B、RQ65B

■60℃显示机型

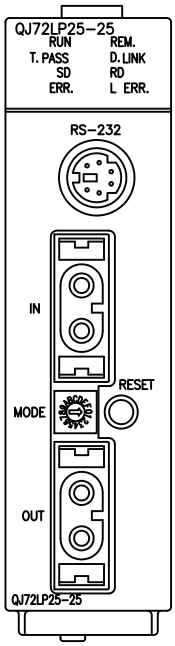
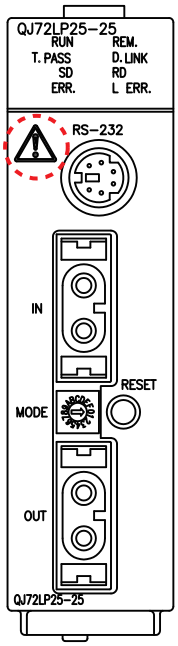
上述以外的模块

5.3 模块前部的标记变更 （仅限MELSEC-Q系列）

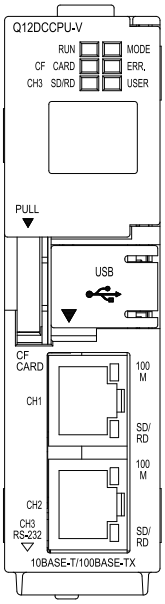
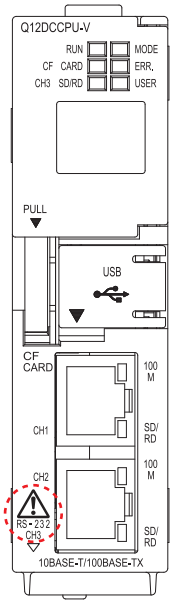
过程CPU和冗余CPU

变更前 （例如：过程CPU）	变更后 （例如：过程CPU）
	

MELSECNET/H远程输入输出模块

变更前	变更后
	

C语言控制器模块

变更前	变更后
	

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
—	2016年11月	第一版
A	2017年11月	添加了变更时期为2017年9月及以后的机型。
B	2018年6月	已支持e-Manual。
C	2019年4月	添加了2019年4月及以后的额定铭牌。
D	2022年5月	添加了变更时期为2022年6月及以后的机型。